

ChaMP

Chemical Mechanical Planarizers

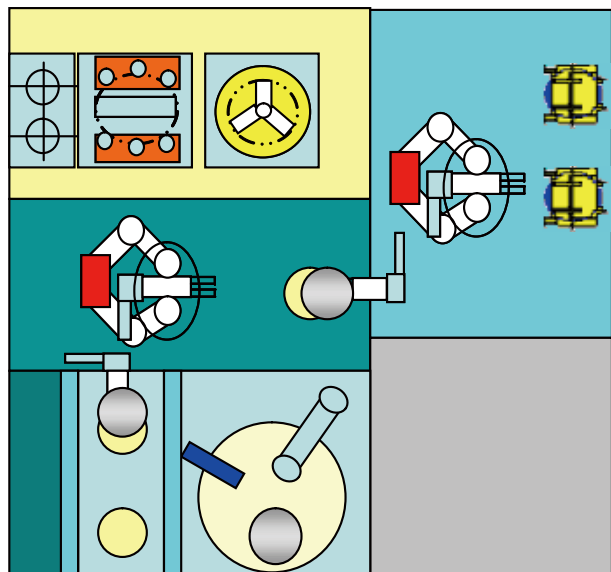
小型 CMP 装置

特徴

- 低価格
 - 小フットプリント
 - 高性能 CMP → 半導体デバイス量産ラインで培った技術を搭載
 - お客様のご要望に応じて、装置仕様変更が可能 → R&D から試作、量産まで拡張可能
-
- 2～8インチ研磨ヘッドを提供可能 → 同じボディ上で、異なるウェーハサイズの研磨が可能
 - ウェーハローダ搭載により、フルオート動作が可能
 - 洗浄ユニット搭載により精密洗浄が可能



ChaMP



【仕様①】
セミオートタイプ CMP 装置



【仕様②】
簡易ローダー付自動 CMP 装置

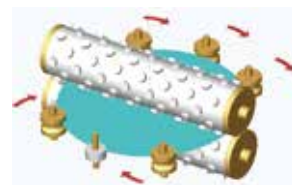


【仕様③】
ローダー & 洗浄機付き自動 CMP 装置

※洗浄機単体での販売も可能です

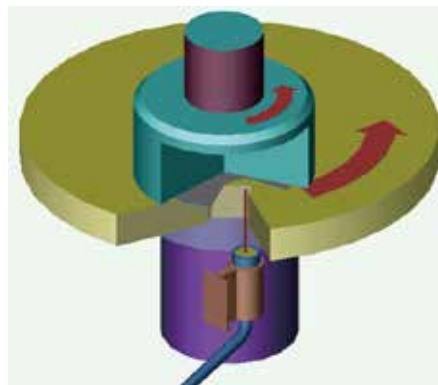
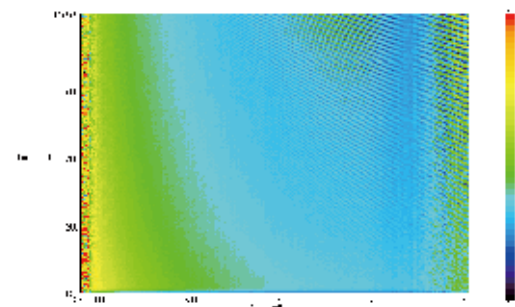
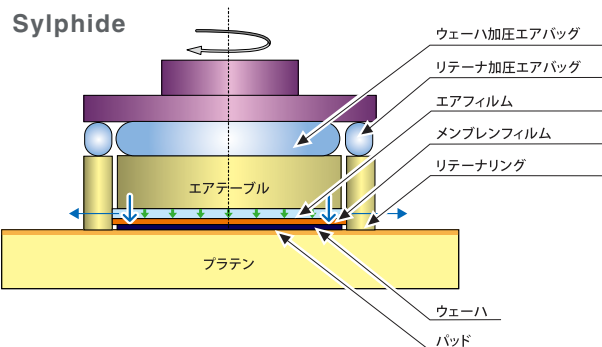
エアフロート式ヘッド “Sylphide”

- エアフィルム形成により、ウェーハ面内で非常に**均一な加圧**を実現
- エアフィルムと独立したエアバッグを持つことで**低圧での安定性**を実現
- 独立したリテーナ加圧エアバッグにより良好な**エッジプロファイル制御**を実現
- リテーナ・メンブレンの**ワンタッチ交換**によるダウンタイムの低減（下記参照）
- ゾーンコントロール機能**の追加可能（オプション）



Optical End-Point Detection System

- 白色光源を用い、広い波長領域の反射データと特殊アルゴリズムで正確に残膜変化を検出
- 幅広いアプリケーションの提供



量産に向けての各種オプション機能をご用意しています。